



IEC 60539-2

Edition 1.0 2003-11

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Directly heated negative temperature coefficient thermistors –
Part 2: Sectional specification – Surface mount negative temperature coefficient
thermistors**

**Thermistances à coefficient de température négatif à chauffage direct –
Partie 2: Spécification intermédiaire – Thermistances à coefficient de
température négatif pour montage en surface**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

S

ICS 31.040.30

ISBN 978-2-88912-044-4

CONTENTS

FOREWORD	4
1 General	6
1.1 Scope.....	6
1.2 Normative references	6
1.3 Information to be given in a detail specification	6
1.3.1 Outline drawing and dimensions	7
1.3.2 Mounting	7
1.3.3 Ratings and characteristics.....	7
1.4 Terminology	7
2 Preferred ratings and characteristics	7
2.1 Tolerances on rated zero-power resistance	7
2.2 Climatic categories.....	7
3 Quality assessment procedures	8
3.1 Primary stage of manufacture.....	8
3.2 Structurally similar components	8
3.3 Qualification approval procedures	8
3.3.1 The manufacturer shall comply with 3.4 of IEC 60539-1.....	8
3.4 Quality conformance inspection	8
3.4.1 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure	8
3.5 Quality conformance inspection	10
3.5.1 Formation of inspection lots.....	10
3.5.2 Test schedule.....	11
3.5.3 Delayed delivery.....	11
3.5.4 Assessment level.....	11
4 Test and measurement procedures.....	12
4.1 Mounting	12
4.2 Drying and recovery	12
4.2.1 Drying	12
4.2.2 Recovery	12
4.3 Visual examination and check of dimensions	12
4.3.1 Visual examination	12
4.3.2 Requirements	12
4.3.3 Marking	14
4.3.4 Dimensions	14
4.4 Electrical tests.....	14
4.4.1 Zero-power resistance	14
4.4.2 B-value or resistance ratio	14
4.4.3 Resistance/temperature characteristic	15
4.5 Thermal tests	15
4.5.1 Dissipation factor (δ).....	15
4.5.2 Thermal time constant by cooling after self-heating (τ_c).....	15
4.6 Resistance to soldering heat	15
4.6.1 Initial measurement	15
4.6.2 Test conditions	15
4.6.3 Recovery	16

4.6.4	Final inspection, measurements and requirements	16
4.7	Solderability	16
4.7.1	Test conditions	16
4.7.2	Recovery	17
4.7.3	Final inspection, measurements and requirements	17
4.8	Rapid change of temperature	17
4.9	Thermal shock.....	17
4.10	Climatic sequence	18
4.10.1	Initial measurements	18
4.10.2	Dry heat	18
4.10.3	Damp heat (cyclic), first cycle	18
4.10.4	Cold	18
4.10.5	Damp heat (cyclic), remaining cycles	18
4.10.6	Final measurements	19
4.11	Damp heat, steady state.....	19
4.12	Endurance.....	19
4.12.1	Endurance at θ_3 and P_{max}	19
4.12.2	Endurance at upper category temperature	19
4.13	Shear (adhesion) test.....	20
4.14	Substrate bending test	20
4.15	Component solvent resistance.....	20
4.16	Solvent resistance of marking.....	20
Annex A (normative)	Guide for the specification and coding of dimensions of surface mount negative temperature coefficient thermistors	21
Figure 1 – Fault: fissure or defect	13	
Figure 2 – Fault: crack	13	
Figure 3 – Separation or delamination	13	
Figure 4 – Exposed electrodes.....	13	
Figure 5 – Principal faces	14	
Figure A.1 – Dimensioning of surface mount thermistors.....	21	
Table 1 – Upper and lower category temperatures and duration of the damp heat test.....	8	
Table 2 – Fixed sample size test schedule for qualification approval of surface mount negative temperature coefficient thermistors Assessment level EZ	10	
Table 3 – Lot-by-lot inspection	11	
Table 4 – Periodic test.....	12	
Table 5 – Number of cycles	18	
Table A.1 – Dimensions	21	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIRECTLY HEATED NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTORS –

Part 2: Sectional specification – Surface mount negative temperature coefficient thermistors

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60539-2 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment.

This bilingual version, published in 2010-07, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/1346/FDIS	40/1368/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

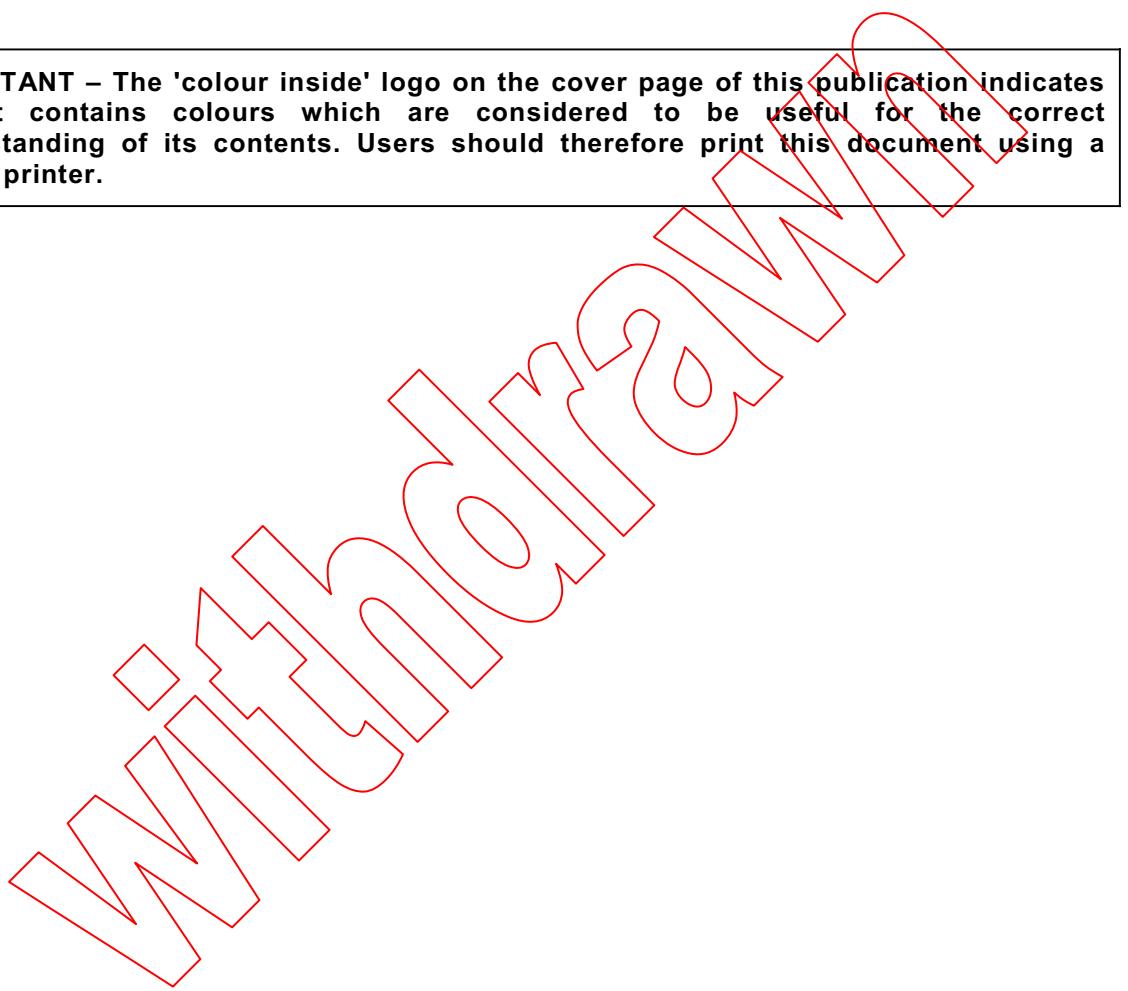
The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.



DIRECTLY HEATED NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTORS –

Part 2: Sectional specification – Surface mount negative temperature coefficient thermistors

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60539 is applicable to surface mount directly heated negative temperature coefficient thermistors, typically made from transition metal oxide materials with semiconducting properties. These thermistors have metallized connecting pads or soldering strips and are intended to be mounted directly on to substrates for hybrid circuits or on to printed boards.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-2:1974, *Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat*
Amendment 1 (1993)
Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-14:1984, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature*
Amendment 1 (1986)

IEC 60068-2-30:1980, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)*
Amendment 1 (1985)

IEC 60068-2-58:1999, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60068-2-78: *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60410:1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 60539-1:2002, *Directly heated negative temperature coefficient thermistors – Part 1: Generic specification*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	24
1 Généralités.....	26
1.1 Domaine d'application	26
1.2 Références normatives.....	26
1.3 Informations à spécifier dans une spécification particulière	26
1.3.1 Dessin d'encombrement et dimensions	27
1.3.2 Montage	27
1.3.3 Valeurs assignées et caractéristiques.....	27
1.4 Terminologie	27
2 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles.....	27
2.1 Tolérances sur la résistance de puissance nulle assignée	27
2.2 Catégories climatiques	28
3 Procédures d'assurance de la qualité	28
3.1 Étape initiale de fabrication	28
3.2 Composants de structure semblable	28
3.3 Procédures d'homologation	28
3.3.1 Le fabricant doit être en conformité avec le Paragraphe 3.4 de la CEI 60539-1	28
3.4 Contrôle de conformité de la qualité	28
3.4.1 Homologation basée sur la procédure avec une taille d'échantillons fixe	28
3.5 Contrôle de conformité de la qualité	30
3.5.1 Formation des lots d'inspection	30
3.5.2 Programme d'essai	31
3.5.3 Livraison différée	31
3.5.4 Niveau d'assurance	31
4 Procédures d'essai et de mesure.....	32
4.1 Montage	32
4.2 Séchage et rétablissement	32
4.2.1 Séchage	32
4.2.2 Rétablissement	33
4.3 Examen visuel et contrôle des dimensions	33
4.3.1 Examen visuel	33
4.3.2 Exigences	33
4.3.3 Marquage	35
4.3.4 Dimensions	35
4.4 Essais électriques	35
4.4.1 Résistance de puissance nulle	35
4.4.2 Valeur B ou rapport de résistance	35
4.4.3 Caractéristique résistance/température	35
4.5 Essais thermiques	35
4.5.1 Facteur de dissipation (δ)	35
4.5.2 Constante de temps thermique par refroidissement après auto- chauffage (τ_C)	35
4.6 Résistance à la chaleur de soudage	36
4.6.1 Mesure initiale	36
4.6.2 Conditions d'essai	36

4.6.3 Rétablissement.....	36
4.6.4 Exigences, mesures et inspection finale	36
4.7 Soudabilité	37
4.7.1 Conditions d'essai	37
4.7.2 Rétablissement.....	37
4.7.3 Exigences, mesures et inspection finale	37
4.8 Variation rapide de température	37
4.9 Choc thermique	38
4.10 Séquence climatique	38
4.10.1 Mesures initiales	38
4.10.2 Chaleur sèche	39
4.10.3 Chaleur humide (cyclique), premier cycle	39
4.10.4 Froid.....	39
4.10.5 Chaleur humide (cyclique), cycles restants	39
4.10.6 Mesures finales	39
4.11 Chaleur humide, essai continu.....	39
4.12 Endurance.....	40
4.12.1 Endurance à θ_3 et P_{max}	40
4.12.2 Endurance à la température de catégorie élevée.....	40
4.13 Essai de cisaillement (adhérence).....	41
4.14 Essai de courbure du substrat	41
4.15 Résistance des composants au solvant.....	41
4.16 Résistance du marquage au solvant.....	41
Annexe A (normative) Guide pour la spécification et le codage des dimensions des thermistances à coefficient de température négatif pour montage en surface	42
Figure 1 – Anomalie: fente ou défaut	33
Figure 2 – Anomalie: fissure	33
Figure 3 – Séparation ou décollement.....	34
Figure 4 – Electrodes exposées	34
Figure 5 – Faces principales.....	34
Figure A.1 – Dimensionnement des thermistances pour montage en surface	42
Tableau 1 – Température maximale et minimale de catégorie, et durée de l'essai chaleur humide	28
Tableau 2 – Programme d'essai avec une taille d'échantillons fixe pour l'homologation de thermistances à coefficient de température négatif pour montage en surface Niveau d'assurance EZ.....	30
Tableau 3 – Inspection lot par lot	32
Tableau 4 – Essai périodique.....	32
Tableau 5 – Nombre de cycles	39
Tableau A.1 – Dimensions	42

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

THERMISTANCES À COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE NÉGATIF À CHAUFFAGE DIRECT –

Partie 2: Spécification intermédiaire – Thermistances à coefficient de température négatif pour montage en surface

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60539-2 a été établie par le comité d'études 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

La présente version bilingue, publiée en 2010-07, correspond à la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1346/FDIS et 40/1368/RVD.

Le rapport de vote 40/1368/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

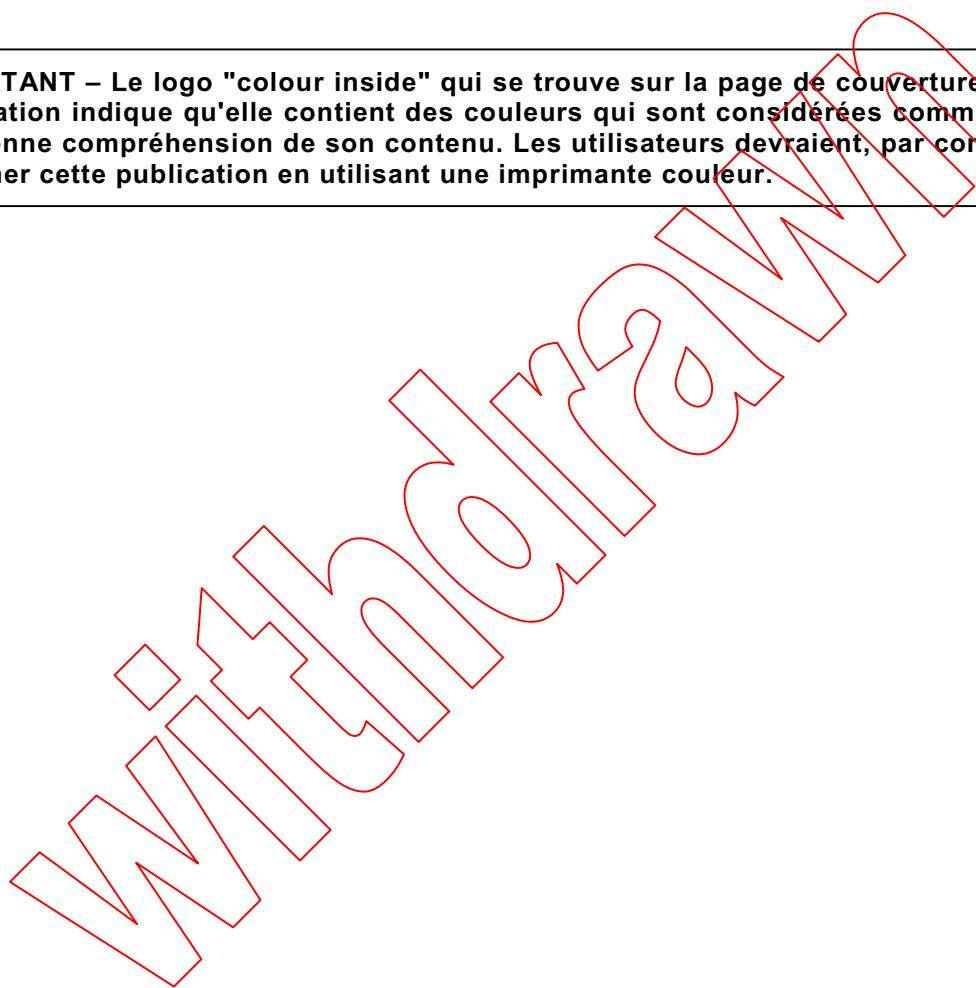
La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.



THERMISTANCES À COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE NÉGATIF À CHAUFFAGE DIRECT –

Partie 2: Spécification intermédiaire – Thermistances à coefficient de température négatif pour montage en surface

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60539 s'applique aux thermistances à coefficient de température négatif à chauffage direct pour montage en surface, typiquement constituées de matériaux faits d'oxyde de métal de transition dotés de propriétés semi-conductrices. Ces thermistances sont équipées de contacts de connexion métallisés ou de bandes de soudure et sont destinées à être montées directement sur des substrats pour circuits hybrides ou sur des cartes imprimées.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-2:1974, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais - Essais B: Chaleur sèche*

Amendement 1 (1993)

Amendement 2 (1994)

CEI 60068-2-14:1984, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais - Essai N: Variations de température*

Amendement 1 (1986)

CEI 60068-2-30:1980, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais - Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

Amendement 1 (1985)

CEI 60068-2-58:1999, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)* (disponible en anglais seulement)

CEI 60068-2-78: *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

CEI 60410:1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

IEC 60539-1:2002, *Directly heated negative temperature coefficient thermistors – Part 1: Generic specification* (disponible en anglais seulement)